

证券代码：301095

证券简称：广立微

## 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流
活动参与人员	广发基金、国富基金、南方基金、华宝基金、宝盈基金、华安证券、交银施罗德、平安养老、混沌投资、东证资管、明澄投资、冲和投资、西部利得基金、中信建投、摩根士丹利华鑫基金、鸿道投资、华创证券、聚鸣投资、和谐汇一资管、西南证券、华泰证券、中信证券、中银国际证券、招银理财、长安基金、金友创智资、安信基金、雪石资产、新华基金，共 29 家机构
时间	2022 年 8 月 30 日 15:00—16:00
地点	公司会议室
形式	电话会议
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李莉莉
交流内容及具体问答记录	<b>一、公司业务情况简介</b> 公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司依托软件工具授权、软件技术开发和测试机及配件三大主业，提供 EDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

董事会秘书陆春龙对公司基本情况及 2022 年半年度报告做了概括介绍。

## 二、问答环节

### 1、请问设计端 EDA 和制造端 EDA 的区别？公司的 EDA 给客户提供的主要价值在哪里？

设计类 EDA 关注如何把芯片设计出来；制造类 EDA 关注如何把芯片制造出来，通过找到问题或缺陷而帮助芯片顺利量产制造。

公司的 EDA 软件及成品率提升整体方案，能够帮助晶圆厂快速找到问题缺陷，从而指导工艺改进和芯片设计的改善，在不使用相关成品率提升方案的情况下，晶圆厂的工艺开发会相对缓慢，导致其整个工艺平台成熟周期长。

### 2、公司 WAT 测试设备业务情况、市场竞争力及未来的发展计划？

WAT (Wafer Acceptance Test) 又被称为晶圆允收测试，位于晶圆完成制作工艺流程之后、晶圆测试 (CP) 之前，用来测量特定结构的电性参数，以检验制造过程的质量、稳定性及工艺平台的电性规格等是否满足要求，对晶圆的生产制造进行精确控制和评估，贯穿于晶圆生产的整个工艺制造过程。

WAT 测试机是集成电路制造环节必备的设备之一，公司 WAT 测试设备在近两年才开始规模化进入新建晶圆厂量产线。公司的 WAT 测试设备以往收入规模较小，相对于 EDA 软件，其具有单价较高、一经验证通过后的推广周期相对短的特点，因此近两年呈现爆发式增长态势，2020 年销售 6 台，2021 年销售 20 台。近两年，随着集成电路国产化需求的提升，特别是芯片自给率的必要性，国内晶圆厂出现“建厂潮”将会极大地促进 WAT 测试机的市场需求，推动公司该块业务的快速增长。

公司在多年自主研发 WAT 测试设备的历程中，掌握了晶圆级电性测试设备并行测试技术、片内测试加速方法等业界领先的关键核心技术，使产品实现了高质量的国产替代且具有国际水平的市场竞争

力。未来，公司的 WAT 测试设备规划，会加快对 T4000 型号测试设备的升级优化，满足更多元化的客户需求；同时，在汽车电子、第三代半导体等新兴市场的驱动下，公司将会加大投入开发新型晶圆级电性参数测试设备，进一步扩大产品矩阵，拓展更广阔的市场空间。

**3、公司专注于制造类 EDA，请公司介绍一下相关 EDA 软件产品在晶圆厂中的作用。**

公司在成品率提升领域深耕多年，已经形成了全流程的软硬件产品覆盖。在此过程中，公司先从成品率提升 EDA 软件做起，围绕着高效的电性测试方法为主轴，不断外延扩展形成了设计、测试到分析的全流程业务闭环。公司的 EDA 软件主要应用于集成电路成品率提升环节，具体应用场景包括工艺开发、产品导入、量产监控等场景，帮助芯片制造厂商实现良率爬坡和快速量产；而随着集成电路国产线的建立，包括国产设备、耗材的导入，如何保证制造成品率和工艺质量，成品率提升是必不可少的高新技术，因此，将会为公司的成品率提升业务带来更多的增长机遇。

**4、公司在 EDA 方向上的生态布局如何？在软硬件协同方面的情况请介绍一下。**

目前公司在制造类 EDA 方向上产品布局包括：首先，对原有成品率提升领域内的系列 EDA 软件，在不同工艺节点和产品类型上不断升级迭代；其次，公司一直在加大企业研发投入持续拓展其他制造类 EDA 品类，比如量产工艺监控相关 EDA 软件以及半导体数据分析与管理软件，并于去年正式推出了半导体通用数据分析工具，该产品在市场推广的过程中其市场反馈超出预期，今年将会继续推出其他品类数据产品。后期，公司还将会推出更多类型的 EDA 软件产品，不断丰富公司产品矩阵，以软硬件一体化的全流程技术方案为高质量的芯片制造保驾护航。

公司能够提供高效测试芯片的 EDA 软件、WAT 电性测试设备及半导体数据分析与管理软件等产品及服务，实现了软硬件相结合的产品矩阵布局。通过各个环节之间产品的联动，形成了公司软硬件产品及服务的闭环，帮助客户以更低的成本与更快的速度实现成品率的提升，为客户创造更多价值，从而提升了客户粘性。由于产品及服务之间存在联动效应，能够驱动客户扩展采购其他产品，例如，公司的 EDA 软件和电路 IP 相结合能够有效地提升测试芯片的面积利用率，基于公司软硬件协同研发的优势，若增加采购公司的 WAT 测试设备则能够在测试效率上有成倍或更高的提升；另一方面，公司的 WAT 测试设备进入量产线，能够带动公司的高效、高面积利用率的 EDA 设计软件扩展到量产线，不仅扩展了 EDA 软件的市场空间，还使得各项业务之间相互引流，实现协同增长。

#### **5、公司后续计划进行量产环节的 EDA 方案配套吗？**

公司正在研发量产环节的方案。因为公司的可寻址测试芯片能够大幅提升测试结构的设计密度，这种情况下，公司首先要解决测试问题，即公司把测试结构容量增加，而测试时间和原来差别不大，这样才会促使客户更多地采购使用公司的 EDA 软件，目前公司的高测试效率 WAT 设备已经开始规模化进入到量产线，其对公司的 EDA 软件的协同作用将会逐步凸显，因此公司正在加快量产环节工艺监控 EDA 方案的研发。

#### **6、半导体数据分析与管理软件的是否能进一步进行介绍？这块需求情况如何？**

在半导体数据端，公司在集成电路制造环节有长期积累，掌握了反映芯片设计和制造过程的数据含义，并对上述数据信息的进行深度挖掘，巩固公司现有成品率检测技术优势。同时，公司将原有的电性测试数据分析工具延伸开发至覆盖整个集成电路生命周期的半导体数据软件系统，构建适用于多场景（包括设计、制造、封测等）

	<p>数据分析产品生态，极大地扩展了公司数据系统客户群体和市场空间。公司去年研发的半导体通用数据分析已进入市场推广阶段，正在开发的半导体良率分析与管理软件、缺陷管理系统产品也将会于今年发布。另外，公司还正在加速其他品类半导体数据分析与管理软件的研发，以为客户提供更高的产品及市场价值。</p> <p><b>7、公司能否介绍一下数据分析产品客户群体的画像？</b></p> <p>公司数据分析产品贡献收入的客户主要包括设计公司、晶圆厂。因产品今年尚在市场拓展期，目前的试用客户群涵盖了设计公司、晶圆厂以及封测厂。</p> <p><b>8、EDA 软件开发周期长、投入多，公司后续的研发战略计划如何？</b></p> <p>公司将在保持现有业务正常进行的情况下，不断升级优化现有成品率提升方案，并在制造类 EDA 软件、晶圆级电性测试设备、半导体工业数据软件等方面加强布局，持续提升公司软硬件一体化方案的能力，铸就更高的技术壁垒。同时，公司正在积极招募优秀人才加快新技术、新产品开发，公司 2021 年 12 月 31 日拥有员工 169 名，截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工总数已达到 229 名。在研发费用方面，公司 2022 上半年年研发费比去年同期增长 60%以上，后期公司将合理使用超募资金，加大募投项目及新技术、新产品研发力度，以实现公司长远、健康的可持续发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作</p>	<p>无。</p>

---

为附件)	
日期	2022年8月30日